

SPECIFICATIONS

Marketing Name	GeForce RTX™ 5070 Ti 16G VENTUS 3X
Modèle	G507T-16V3
Processeur graphique	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti
Cœurs	8960 unités
Mémoire	16 Go GDDR7
Bus Mémoire	256-bit
Fréquence du GPU	Performances extrêmes : 2467 MHz (MSI Center) Boost : 2452 MHz
Vitesse mémoire	28 Gb/s
Nombre d'écrans supportés	4
Technologie G-SYNC™	Oui
Résolution numérique maximum	7680 x 4320
Support du procédé HDCP	Oui
Bloc d'alimentation recommandé	750 W
Connecteurs alimentation	1 x 16 broches (alimentation ATX 3.1 recommandée)
Sorties	3 x DisplayPort (v2.1b) 1 x HDMI™ (caractéristiques du HDMI™ 2.1b : jusqu'à 4K 480 Hz ou 8K 120 Hz avec DSC, Gaming VRR, HDR)
Version OpenGL	4.6
Dimensions	303 x 121 x 49 mm
Poids	1073 g / 1566 g

CONNECTIONS



1. DisplayPort
2. HDMI™

FEATURES



Trois ventilateurs

Les trois ventilateurs et le large dissipateur assurent un refroidissement efficace et silencieux.



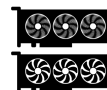
Ventilateurs Torx 5.0

Les pales reliées entre elles par groupes de trois sur leur partie supérieure et le capot du ventilateur travaillent de concert pour stabiliser et maintenir la pression du flux d'air à un niveau élevé.



Caloducs carrés

Les caloducs carrés optimisent leur zone de contact avec la plaque de base du GPU pour un refroidissement optimal.



Technologie Zero Frozr

Zero Frozr arrête les ventilateurs quand la température est réduite et les réactive quand la température augmente.



MSI Center

Le logiciel exclusif MSI Center vous permet de surveiller, modifier et optimiser les performances des produits MSI en temps réel et facilement.



Afterburner

Prenez le contrôle total sur votre carte avec le logiciel d'overclocking de carte graphique le plus apprécié au monde.



Plaque arrière en métal

La plaque arrière métallique robuste dispose de ventilations et de pads thermiques pour optimiser le refroidissement.



Fusibles

Des fusibles supplémentaires intégrés au PCB assurent une protection additionnelle contre les défaillances électriques.



DrMOS

Les étages d'alimentation DrMOS offrent une grande efficacité avec moins de pertes de puissance et des contrôles améliorés de la tension.



Plaque de base en cuivre nickelé

La chaleur émise par le processeur graphique et par la mémoire est immédiatement capturée puis transférée vers plusieurs caloducs.